

Title (en)
Crimp contact for circuit boards

Title (de)
Crimpkontakt für Leiterplatten

Title (fr)
Contact à crimp pour des plaquettes à circuits

Publication
EP 1206005 A1 20020515 (DE)

Application
EP 01100612 A 20010111

Priority
DE 20019171 U 20001110

Abstract (en)
The crimp contact (1) has flat base (2) with solder connection (5), which passes through a recess in the circuit board. Clamping shanks (7,8) provide crimping contact and tension relief for the cable strand. The connection part (5), containing coupling section (4) and the clamp section (6), supporting the clamping shanks, are separate. The clamp section so protrudes from the circuit board as to be freely accessible to the crimping tool.

Abstract (de)
Bei einem auf einer Leiterplatte (12) angebrachten Crimpkontakt (1) zum elektrischen Verbinden wenigstens eines Litzenleiters (9) mit wenigstens einem Lötpad der Leiterplatte (12) besteht der aus einem flachen Basisteil mit einem wenigstens eine Ausnehmung (13) der Leiterplatte durchsetzenden Verbindungsteil (5) zur Lötverbindung mit dem Lötpad in einer Wellenlötanlage und zur zusätzlichen Befestigung an der Leiterplatte (12) sowie mit Klemmschenkeln (7, 8) zur Crimpkontaktierung und Zugentlastung des Litzenleiters (9). Der das Verbindungsteil (5) aufweisende Verbindungsbereich (4) und der die Klemmschenkel (7, 8) tragende Klemmbereich (6) des Basisteils (2) sind voneinander getrennt angeordnet, wobei der Klemmbereich (6) derartig von der Leiterplatte (12) abragt, dass er für das Crimpwerkzeug frei zugänglich ist. Der genannte Crimpkontakt ist damit auf einfache und kostengünstige Weise derart ausgebildet, dass ein besonderer Aufwand an der Wellenlöteinrichtung sowie die Gefahr von Beschädigungen der Litzenleiterisolation in der Wellenlöteinrichtung wirksam vermieden sind. <IMAGE>

IPC 1-7
H01R 11/16; **H01R 4/18**; **H01R 12/32**

IPC 8 full level
H01R 4/18 (2006.01); **H01R 11/16** (2006.01); **H01R 12/55** (2011.01)

CPC (source: EP)
H01R 4/185 (2013.01); **H01R 12/57** (2013.01); **H01R 4/187** (2013.01)

Citation (search report)
• [XY] DE 1273022 B 19680718 - IBM
• [YA] DE 19644794 A1 19970507 - WHITAKER CORP [US]
• [A] DE 4324917 A1 19940203 - GROTE & HARTMANN [DE]

Cited by
FR2842029A1; CN103855836A; EP1467432A1; DE102010038465A1; EP1471603A3; DE102006025661B4; DE102006025661A1; US7098857B2; US7009569B2; US9065188B2

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)
DE 20019171 U1 20010111; EP 1206005 A1 20020515

DOCDB simple family (application)
DE 20019171 U 20001110; EP 01100612 A 20010111